

APPENDIX

最小発注数量 Minimum Order Quantity

- 御発注の際には、テーピング包装の場合はテーピング数量の整数倍にてお願い致します。
- バルク発注になる場合には、下記基本単位の整数倍にてお願い致します。
- You are kindly requested to place orders in a taping quantity by integral times for taping packages and in the under-mentioned basic unit by integral times for bulk packages.

テーピングの場合の数量は製品別ページを参照下さい。

Please refer to the pages by product for taping packages.

■チップ部品 Chip Components

形名 Type	基本単位/袋 Basic Unit/Bag	入数/箱 Qty/Box	テーピング対応 Taping
PT72	2A・2B	200pcs	○
NT73	1J~2B	200pcs	○
LA73	1J~2B	200pcs	○
LT73	2A・2B	200pcs	○
LP73	1J~2B	100pcs	○
SDT73H,SDT73V	2B	100pcs	○
MLT	2B	2000pcs	○
	2E	2000pcs	○

■ディスクリート部品 Discrete Components

形名 Type	基本単位/袋 Basic Unit/Bag	入数/箱 Qty/Box	テーピング対応 Taping
LT	1/6	—	○
	1/4	—	○
LP	1/16	100pcs	○
	1/8	100pcs	○
SDT101	A	100pcs	○
	B	100pcs	—
SDT310	100pcs	1000pcs	—

推奨ランド寸法

Recommended Pad Dimensions

■標準ランド寸法 Standard Soldering Pad Dimensions

はんだ付け時の最適ランド寸法は条件によって異なりますが、標準的には次のランド寸法を推奨致します。

The optimum dimension of soldering pad at the time of soldering differs according to conditions, however, the following lands are recommended as standard.

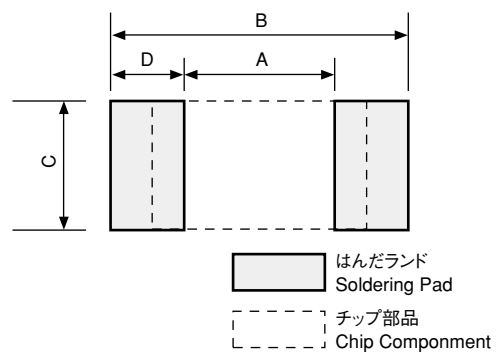
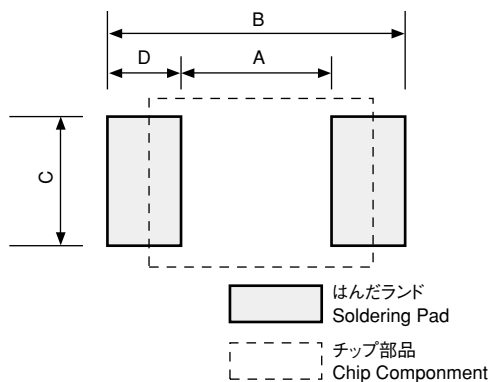
■角形チップ部品 Flat Type Components

- リフローはんだ用 For Reflow Soldering

形名 Type	形状 Style	寸法 Dimensions (mm)				
		部品サイズ Component Size	A	B	C	D
PT72 NT73 LA73	1J	1.6×0.8	1.0	2.0	0.6	0.5
LT73 LP73 SDT73						
	2A	2.0×1.25	1.3	2.5	1.05	0.6
	2B	3.2×1.6	2.2	4.0	1.4	0.9

- フローはんだ用 For Flow Soldering

形名 Type	形状 Style	寸法 Dimensions (mm)				
		部品サイズ Component Size	A	B	C	D
NT73 LA73	1J	1.6×0.8	1.0	2.4	0.8	0.7
LT73 LP73 SDT73						
	2A	2.0×1.25	1.3	3.1	1.25	0.9
	2B	3.2×1.6	2.2	4.4	1.6	1.1



E数例

E Series numbers

■公称抵抗値の有効数字 Significant figures of Nominal resistance

E6	1.0		1.5		2.2		3.3		4.7		6.8	
E12	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2
E24	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0
	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1

